

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-053

华海清科股份有限公司

关于 12 英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●近日，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile-GP300 完成首台验证工作。

●该机台验收通过标志着 12 英寸超精密晶圆减薄机性能获得客户认可，满足客户批量化生产需求，将有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。

●12 英寸超精密晶圆减薄机尚需市场推广和更多客户对该产品进行验证，存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

一、超精密晶圆减薄机验收基本情况

自公司 2023 年推出新一代 12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile-GP300 量产机台以来，公司积极推进客户端导入工作，该机型已发往存储、先进封装、CIS 等不同工艺的客户端进行验证。近日，公司 12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile-GP300 完成首台验证工作。

Versatile-GP300 机台通过创新布局，集成超精密磨削、抛光及清洗单元，配置先进的厚度偏差与表面缺陷控制技术，提供多种系统功能扩展选项，具有高精度、高刚性、工艺开发灵活等优点，可以满足集成电路、先进封装等制造工艺的晶圆减薄需求。

该验收机台应用于客户先进工艺，突破了传统减薄机的精度限制，实现了减薄工艺全过程的稳定可控，核心技术指标达到了国内领先和国际先进水平，在客户端表现优异，获得客户高度认可。

二、超精密晶圆减薄机验收对公司的影响

Versatile-GP300 首台验收通过标志着其性能获得客户认可，满足客户批量化生产需求，有助于推进该机型在不同客户不同工艺的生产线进一步验证，完善技术指标，为后续取得批量订单打下坚实基础；同时随着 HBM 等先进封装技术的应用，将大幅提升市场对减薄装备的需求，将有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、相关风险提示

公司 12 英寸超精密晶圆减薄机尚需市场推广和更多客户对该产品进行验证，存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 20 日